

1	2	3	4
---	---	---	---

가공											수 정 내 용				
ST											부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기준)											△				
ST(개선)											△				

A

B

6	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00052-135/1 (PH006)
5	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00055-1/1 (MH027)
4	INSERT	1	MBsBD	Nickel Plate	DIS00054-135/1 (MH026)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00786-N/1 (HH038)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00810-1345/1 (EH050)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	(DH078)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	.* ±0.1 .** ±0.05 년월일 1997. 2. 24. 승인 감도 재도 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017					
재질				도명 CONNECTOR		
열처리						
보호피막처리				작성부서 적도 2/1 연 구 소 단위 mm 총량		